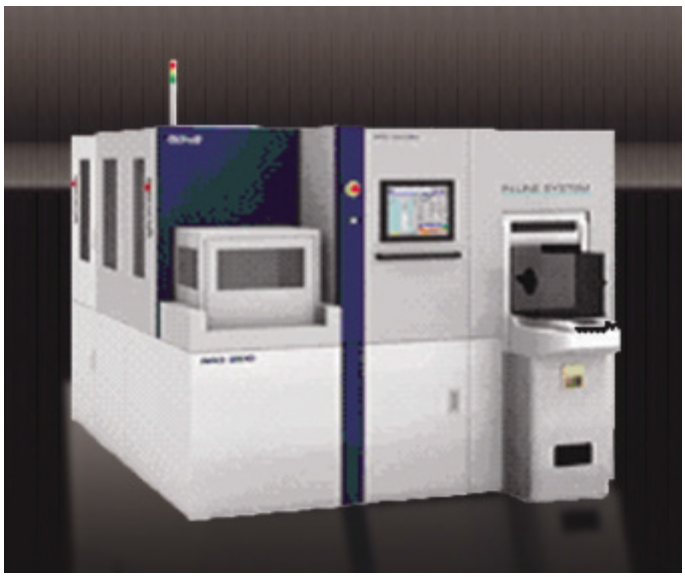
Adwill®
will give you the Advantage

300mm全自动多功能晶圆贴合机

RAD-2510F/12Sa



概述

本机是一种最适用于超薄晶圆加工的多功能晶圆切割胶带贴合机。
背面研磨工艺完成后，晶圆研磨胶用表面保护胶带紫外照射、
晶圆校准、晶圆切割胶带贴合、
研磨用表面保护胶带撕膜均可以由1台设备完成。

可与DISCO公司生产的“DFG8000系列”、“DGP8000系列”联机，
也适用于超薄型芯片制造的新一代DBG™工艺。

为防止晶圆破损，减少单体晶圆的传输次数，单机系统可减少至4次，
与晶圆背面研磨机联机时可减少至2次。

选配功能

- 主机通信功能
  （通信方式：SECS-I、HSMS标准；软件：GEM标准）
- 视觉系统（晶圆ID读取器&条形码粘贴系统）
- 切割胶带预切割系统
- 对应DBG™工艺
- 可与DISCO公司生产的“DFG8000系列”“DGP8000系列”联机生产

适用的胶带

- 切割胶带“Adwill D系列”、“Adwill G系列”
- 粘晶切割胶带“Adwill LE胶带

规格

额定电源	供电电压	: AC200 ㅗ10%)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 3相
	功耗	: 8.0kW (200VAC)
气源	供气压力	: 0.6-0.8MPa
	耗气量	: >800L/分钟（ANR）
真空供给	真空压力	: >-80kPa

适用的晶圆尺寸 200mm, 300mm

尺寸
机台宽度(W) : 2,165mm
设备纵深(D) : 3,090mm
设备高度(H): 1,800mm
（凸出物及三色警示灯除外）

重量 3,100kg

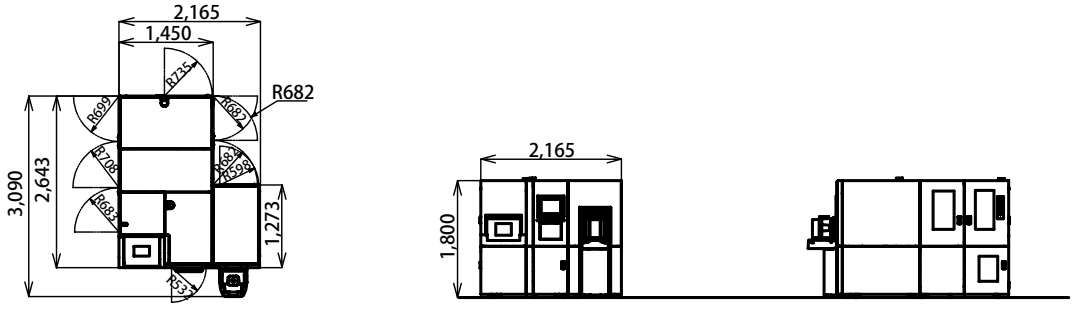
UPH 45片/小时

上述处理能力依据的条件如下（单机时）。

晶圆	: 未研磨300mm镜面晶圆
晶圆环	: 适用于300mm的晶圆产品
切割胶带	: Adwill G系列 G-18
研磨用表面保护胶带	:Adwill E系列 E-8180HR

设备外形图

单位:mm



平面图　正面图　右侧面图

LINTEC Corporation *Linking your dreams*

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

https://www.adwill-global.com/cn